

SUMCO 株主通信

第17期 期末

2015年1月1日 ～ 2015年12月31日



INDEX

- 01 ごあいさつ／連結業績ハイライト
- 03 2015年度の事業成績(概要)と
2016年度1Q(1-3月)の業績見通し
- 04 決算Q&A
- 05 特集：300mmの市場動向とスマートフォン向けのトレンド
「監査等委員会設置会社」への移行について
- 07 連結財務諸表
- 09 会社情報
- 10 株式情報・株主メモ



代表取締役 会長兼CEO 橋本 眞幸

ごあいさつ

株主の皆様には日ごろから格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

半導体用シリコンウェーハ市場は、2014年以降2015年上期までは右肩上がりの需要拡大が続き好調に推移しましたが、下期に入り、世界経済の成長鈍化などの影響により需要調整が始まりました。

当社の主力製品である300mmウェーハは、スマートフォンの在庫調整の影響を受け、エピウェーハは調整局面となりましたが、ポリッシュト・ウェーハは通信端末のメモリー容量増大やクラウド・データセンター向け需要に支えられ、堅調に推移しました。一方、200mm以下の小口径ウェーハは、下期以降の世界経済減速等の影響により、民生・産業向けを中心に弱含みました。

このような環境のもと、当社グループでは、「SUMCOビジョン」の方針に基づき、顧客と一体となって最先端技術開発を推進することにより、顧客でのプレゼンスを高め、あわせて、収益基盤の強化に取り組んでまいります。

また、当社は、昨年上半期に実行いたしました「資本増強・資本再構築プラン」の完遂により財務基盤が強化され、下振れ抵抗力の高い柔軟な経営ができる体質になりました。

2015年12月期の配当金につきましては、株主還元をより充実する観点にたち、当期における利益水準、次期以降の見通し、設備投資に係る資金需要、および、内部留保の状況等を総合的に勘案し、年間で1株当たり20円といたしました。

また、当社は、取締役会の監督機能の強化を図るため、「監査等委員会設置会社」へ移行するとともに、役付取締役を廃止し、会長兼CEOおよび社長兼COOを設置いたしました。

今後とも倍旧のご支援、ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

代表取締役 会長兼CEO 橋本 眞幸



第17期 期末 株主通信



代表取締役 社長兼COO 瀧井 道治

株主の皆様には平素より当社へのご理解とご支援を戴き厚く御礼申し上げます。

昨年実行した「資本増強・再構築プラン」による増資により、種類株をすべて買取り消却することで、株式希薄化のリスクを排除し、当社の財務基盤を改善し安定化することができました。

また、過去4年間で継続的に純利益を積み上げ、当社の純資産を1.4倍に拡充することができ、自己資本比率43%、DEレシオ0.9を達成することができました。

今後は更なる体質強化に向けて、先端技術開発や高精度化投資により技術力を強化し、高付加価値品需要を確実に取り込むとともに、継続的コストダウンを推進し、収益基盤を強化しつつ一層の利益をあげて、自己資本比率50%、DEレシオ0.5、の財務体質の達成を目指してまいります。

また、株主様への配当につきましては、設備投資の資金需要、利益の水準等を総合的に判断しながら、3割程度の配当性向を実施することを目途に考えてまいります。

今般、当社はコーポレートガバナンスの強化と業務執行の効率化を図るために、取締役会の監督機能をより一層強化することとし、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を有する「監査等委員会設置会社」へ移行いたします。

また、指名・報酬委員会を設置し、取締役・執行役員の人事・報酬を審議することで、一層の客観性と透明性を確保し、グローバル企業に相応しいマネジメント体制を確立してまいります。

以上の施策により更なる企業価値向上に努めてまいります。

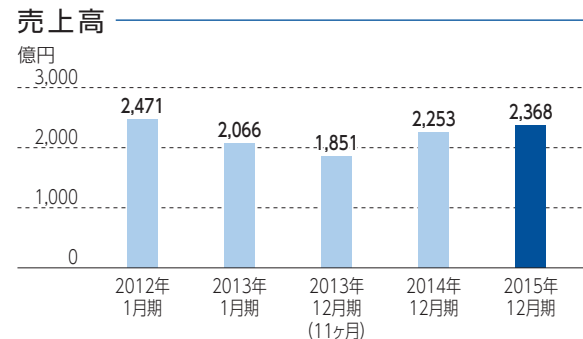
株主の皆様には、今後も引き続きご支援を賜りたくお願い申し上げます。

代表取締役 社長兼COO 瀧井 道治

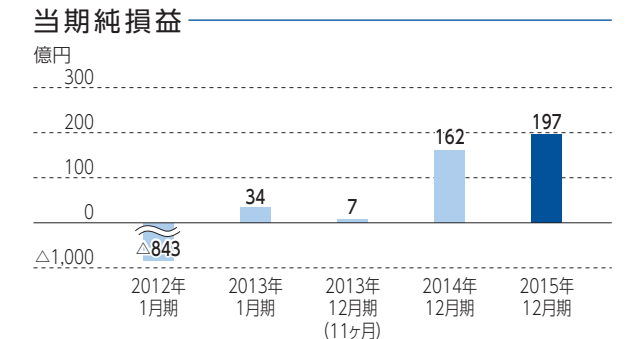
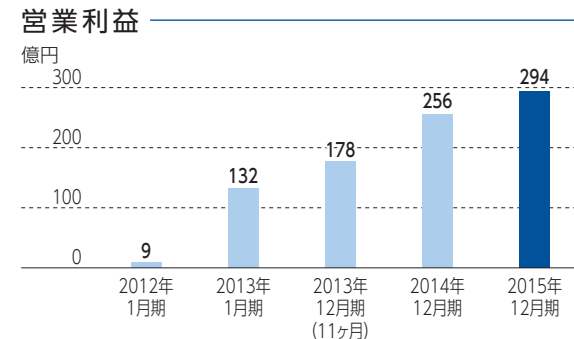


1. 技術で世界一の会社
2. 景気下降局面でも赤字にならない会社
3. 社員が生き活きとした利益マインドの高い会社
4. 海外市場に強い会社

連結業績 ハイライト



注) 日本会計基準。グラフ中の数字は億円未満切り捨て。



2015年度の事業成績(概要)と2016年度1Q(1-3月)の業績見通し

市場環境と事業成績の実績と見通し

2015年
(1-12月)
市場環境

2015年の半導体用シリコンウェーハ市場は、上期は好調に推移しましたが、下期に入り、世界経済の成長鈍化や、中国向けスマートフォンの過剰在庫が顕在化し、需要調整が始まりました。

300mmウェーハは、ロジック向けやDRAM向けで、PCやタブレットの販売低迷に加え、夏場以降から始まったスマートフォンの在庫調整の影響を受けました。一方、NAND向けは、拡大しているクラウドやデータセンター需要に支えられ好調に推移しました。この結果、300mmウェーハの調整は比較的軽微に留まりました。

また、200mm以下の小口径ウェーハは、世界経済の減速等の影響により、民生・産業向けを中心に弱含みました。

2015年
(1-12月)
事業成績

このような事業環境のもと、当社グループでは、「SUMCOビジョン」の方針に基づき、顧客の高精度化要求や製品の差別化に対応した技術開発により顧客でのプレゼンスを高めるとともに、コスト低減による損益分岐点の改善に努めてまいりました。

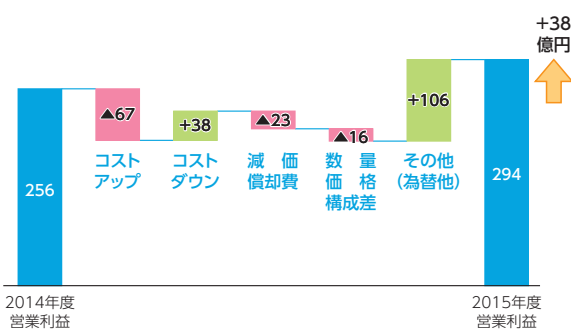
この結果、2015年(1-12月期)の連結業績は、売上高2,368億円、営業利益294億円、経常利益255億円、当期純利益は197億円となり、2014年に比べ増収増益を達成できました。

今後の見通し
2016年
(1-3月)

足許の半導体用シリコンウェーハ市場は、メモリー需要が底堅く推移する中で、昨年秋口から始まったファウンドリーの在庫調整は継続する見通しです。

市場は、1-3月期を底に、次世代スマートフォンの発注等が始まる4-6月期から緩やかに回復に向かうと予想しております。

営業利益増減分析(2014年度→2015年度)



2016年度1Q(1-3月)連結業績予想

(単位:億円)				
項目	2015年4Q実績 (10-12月)	2016年1Q予想 (1-3月)	増減額	増減率
売上高	549	510	△39	△7.0%
営業利益	39	30	△9	△23.5%
経常利益	33	25	△8	△22.9%
純利益	40	10	△30	△75.1%

注1) 業績予想等の将来に対する記述は、当社が現在入手している情報、および、合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。また、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

注2) 本業績予想は、1ドル=120円を前提としています。

決算Q&A

2016年2月9日に開催しました決算説明会における、主な質疑応答をご報告します。

Q 今後の半導体用シリコンウェーハ市場の見通しについて教えて欲しい

A 足許の半導体用シリコンウェーハ市場は、メモリー需要が底堅く推移する中で、昨年秋口から始まったファウンドリーの在庫調整は継続する見通しです。

従い、足許の1Qは、概ね昨年4Qとほぼ同程度の世界出荷になると見ております。

世界経済の動向等、半導体用シリコンウェーハ事業を取り巻く環境は、予断できない状況が続いておりますが、1Qを底に2Qから緩やかに回復すると予想しております。

Q 今後の配当について伺いたい

A 配当に関しては、昨年5月に公募増資を行い、種類株式の買取・消却を実施しましたので、配当の柔軟性が高まりました。

基本的には、当年度の利益水準と次年度以降の利益見通し、および、設備投資などの資金需要や内部留保の状況などを総合的に判断し、約3割程度の配当性向を目途に経営してまいります。

Q 2016年1Qのコスト合理化の中味について教えて欲しい

A 予防保全による機会損失の撲滅と生産性の向上、ならびに、サプライヤーとの緊密な協力関係の構築をベースとしたVA提案による購入物品のコスト低減などの積み上げです。

今回、当社の主力製品である300mm世界市場の動向とその需要を牽引するスマートフォンのトレンドについてご紹介します。

世界の300mmシリコンウェーハは短期的な季節変動はありますが、中期的には年々拡大しており、特に14年春以降15年前半まで強い需要が続きました。15年後半に調整模様となりましたが、年平均では約5百万枚／月が出荷され、過去最高となりました。

16年1Q(1-3月)は、昨年後半からの調整の影響が残り、15年4Q並の世界出荷を予想しています。

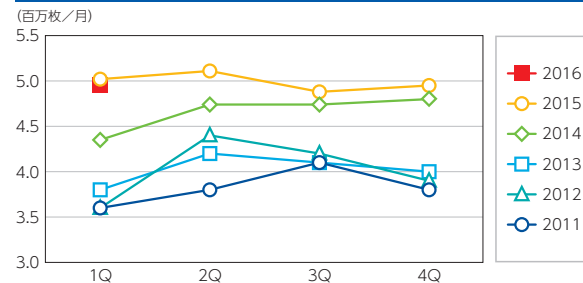
過去のトレンドでは、2Qは回復するのが常ですが、回復の度合いはその年のマクロ経済動向などの影響により異なります。

スマートフォン向け300mmシリコンウェーハ需要は、その世界出荷のおおよそ1/3程度と推察しています。

スマートフォンの世界出荷台数は、2015年の約14億台強から2018年には約18億台にまで拡大すると予想されています。

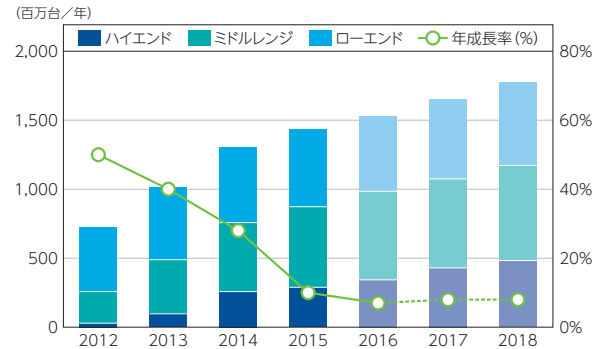
また、スマートフォン1台当たりの300mmシリコンウェーハの搭載量は、年々拡大しています。我々消費者は、より高性能なものを求めるので、プロセッサの機能向上、搭載メモリー容量の拡大、自撮りカメラ機能の追加やデュアル・カメラ機能化など、スマートフォンの機能向上に伴って300mmシリコンウェーハは増え続けます。

300mmウェーハの季節変動(世界の出荷数量)



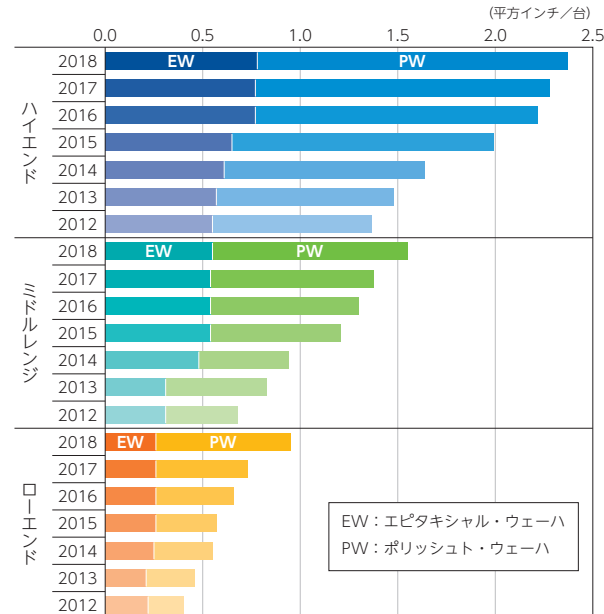
【出典：統計を基にSUMCO作成】

スマートフォンの出荷台数トレンド(2012-2018)



【出典：各種調査会社推定実績・予測を基にSUMCO作成】

スマートフォン1台当たりの300mm消費量の増加傾向

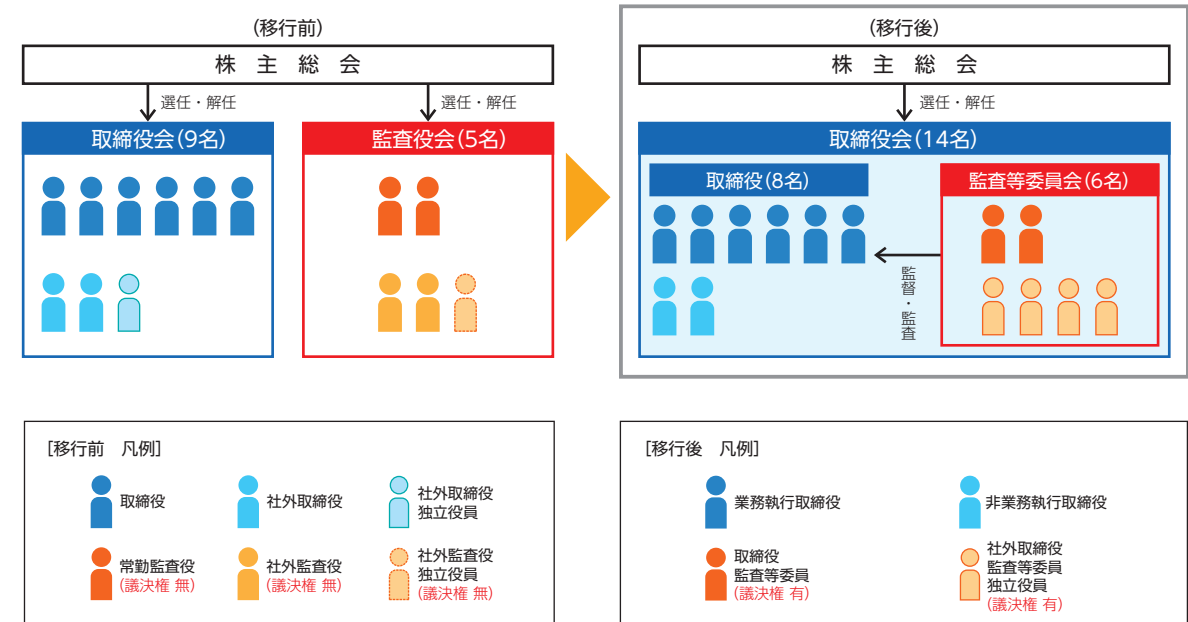


【出典：各種調査会社の情報を参考にSUMCO作成】

3月29日の株主総会后、「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」に移行し、グローバル企業に相応しいガバナンス体制を構築します。

- 当社は、2005年4月に執行役員制を導入し、経営の執行と監督を分離することにより、迅速な意思決定と業務執行における透明性・公平性の確保を図りコーポレート・ガバナンス体制の強化を行ってまいりました。
- 今般、事業環境のグローバル化が進展する中で、取締役会の監督機能をより一層強化することを目的に、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を有する監査等委員会設置会社へ移行いたします。

【コーポレート・ガバナンス体制】



連結財務諸表

Table with 5 columns: Item, Previous Period, 2014 Period, Current Period, and 2015 Period. Rows include Sales, Operating Profit, Net Profit, etc.

当期の連結損益計算書のポイント

売上高
2015年の半導体用シリコンウェーハ市場は、上期は好調に推移しましたが、下期に入り、世界経済の成長鈍化などの影響により、200mm以下の小口径を中心に弱含みになりました。その結果、売上高は前期比115億円増の2,368億円になりました。

営業利益
減価償却費の増加などはありませんでしたが、円安による売上増に加え、コスト低減も進めた結果、営業利益は前期比38億円増の294億円になりました。

経常利益
営業外収益の9億円を加え、支払利息32億円を含む営業外費用48億円を差し引いた結果、経常利益は前期比36億円増の255億円になりました。

当期純利益
インドネシアの土地売却益3億円、インドネシア工場の一部設備および国内遊休資産の減損処理による特別損失20億円、ならびに、法人税等(米子子会社の繰延税金資産計上を含む)4億円、少数株主利益36億円を差し引いた結果、当期純利益は前期比35億円増の197億円になりました。

設備投資 他
設備投資金額(検収ベース)は157億円、減価償却費は217億円で、EBITDAは528億円でした。

※EBITDA:営業利益+営業内減価償却費+のれん償却額で計算され、利益水準を示す指標の一つ

Table with 5 columns: Item, Previous Period, 2014 Period, Current Period, and 2015 Period. Rows include Assets, Liabilities, Equity, etc.

Table with 5 columns: Item, Previous Period, 2014 Period, Current Period, and 2015 Period. Rows include Operating Cash Flow, Investing Cash Flow, Financing Cash Flow, etc.

当期の連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書のポイント

資産合計
優先株の買取に備えて厚め保有していた現預金等を減少させたことなどによる流動資産の69億円減少、償却進行などによる固定資産の137億円減少により、資産合計は前期末比207億円減の4,898億円になりました。

負債合計
有利子負債(長短借入金+リース債務)の406億円減少などにより、負債合計は前期末比485億円減の2,453億円になりました。

純資産合計
当期純利益の計上に加え、新株発行、種類株式の買取・消却などにより、純資産合計は前期末比278億円増の2,445億円になりました。

自己資本比率、D/Eレシオ
自己資本は前期末比266億円増の2,116億円となり、自己資本比率は43.2%、D/Eレシオは0.9倍になりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益の増加などにより、前期比19億円増の317億円になりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー
主に設備取得による支出により、前期比36億円増の△134億円になりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー
新株発行による収入、種類株式の買取・消却による支出、長期借入金の返済、配当金の支払などにより△381億円となりました。

※自己資本比率:総資産に対する自己資本の割合
※D/Eレシオ:自己資本に対する有利子負債の割合

会社情報

(2015年12月末現在)

会社概要

商号	株式会社SUMCO		
本社	〒105-8634 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館 Tel：03-5444-0808 http://www.sumcosi.com/		
設立年月日	1999年7月30日		
資本金	138,718百万円		
従業員数	連結 7,480名 単体 3,489名		
IRお問い合わせ先	広報・IR室：03-5444-3915		

取締役 (2016年3月29日現在)

代表取締役	会長兼CEO	橋 本 眞 幸
	社長兼COO	瀧 井 道 治
	副社長	遠 藤 晴 充
取締役	専務執行役員	降 屋 久
	専務執行役員	平 本 一 男
	常務執行役員	井 上 文 夫
		目 代 史 朗
		前 川 晋
取締役	監査等委員	吉 川 博
		片 濱 久
		田 中 等 *
		三 富 正 博 *
		太 田 信一郎 *
		中 西 孝 平 *

※ 社外取締役(独立役員)

事業所		
本社	東京	
営業拠点	東京、大阪、福岡	
製造拠点	九州事業所 伊万里工場（佐賀県伊万里市）	
	九州事業所 佐賀工場（佐賀県杵島郡江北町）	
	米沢工場（山形県米沢市）	
	千歳工場（北海道千歳市）	
	JSQ事業部（秋田県秋田市）	
連結子会社		
国内	SUMCO TECHXIV株式会社	（長崎、宮崎）
	SUMCOテクノロジー株式会社	（千葉）
	SUMCOサービス株式会社	（佐賀）
	SUMTECサービス株式会社	（長崎）
	SUMCO保険サービス株式会社	（長崎）
	日本台塑勝高株式会社	（佐賀）
海外	SUMCO Phoenix Corporation	（米国）
	SUMCO Southwest Corporation	（米国）
	SUMCO Funding Corporation	（米国）
	STX Finance America, Inc	（米国）
	SUMCO Personnel Services Corporation	（米国）
	SUMCO Europe Sales Plc	（英国）
	PT. SUMCO Indonesia	（インドネシア）
	SUMCO Singapore Pte. Ltd.	（シンガポール）
	FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION	（台湾）
SUMCO Taiwan Technology Corporation（台湾）		

株式情報

株式の情報（2016年3月29日現在）		
発行可能株式総数	普通株式	804,000,000株
発行済株式総数	普通株式	293,285,539株
株主数（普通株式）		56,264名
大株主の状況（2015年12月末現在）		（千株未満切捨て）
株主名	持株数（千株）	持株比率（%）
新日鐵住金株式会社	53,933	18.39%
三菱マテリアル株式会社	53,933	18.39%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9,683	3.30%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	8,803	3.00%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	5,956	2.03%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225	4,678	1.60%
MSCO CUSTOMER SECURITIES	3,967	1.35%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	3,468	1.18%
資産管理サービス信託銀行株式会社（年金特金口）	3,137	1.07%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	2,920	1.00%
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関	東京都千代田区	
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区	
郵便物送付先	〒168-0063 東京都杉並区	
電話照会先	Tel：0120-782	
インターネットホームページURL	http://www.sr	

株主メモ



事業年度	毎年1月1日から12月31日まで		
定時株主総会	毎年3月開催		
基準日	定時株主総会 期末配当金 中間配当金	毎年12月31日 毎年12月31日 毎年6月30日	
その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日			
単元株式数	100株		
公告の方法	電子公告とし、当社のホームページ(http://www.sumcosi.com/)に掲載いたします。ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告いたします。		
上場取引所	東京証券取引所 市場第一部(証券コード:3436)		

ホームページのご案内

当社は多くの株主・投資家の皆様にご利用いただけるよう、ホームページの充実を図っております。決算関係資料やニュースリリースなどのほか、当社が製造するシリコンウェーハについての情報なども掲載しております。ぜひご利用ください。

SUMCOホームページ <http://www.sumcosi.com/>

■ **株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会**
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお手続きおよびご照会は、口座のある証券会社にてお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記電話照会先までご連絡ください。

■ **単元未満株式の買取請求について**
単元(100株)未満株式の買取請求につきましては、株主様口座のある証券会社にお申し出ください。
(証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。)

For All Innovation

シリコンウェーハは、普段生活する上では殆ど目にすることがありませんが、あらゆる電子機器に採用されているもので、実は生活に欠かすことができない製品です。

様々な技術革新が電子機器を進化させ、私たちの暮らしを豊かにし、文明を進化させます。より小さく、より大きく、より軽く、より強く、より早く。

技術者達は、過去の偉人達に挑戦し続け、乗り越え、革命を起こします。そして、その挑戦に必ず必要なのがシリコンウェーハの進化です。

社会の進展、人類の進化のためのあらゆる技術革新に貢献する企業であるために、SUMCOIは、挑戦し続けます。

株式会社SUMCO

〒105-8634 東京都港区芝浦1-2-1 シーバンスN館

Tel:03-5444-0808

<http://www.sumcosi.com>

見通しに関する注意事項

本資料に記載された予測・予想・見込み・その他の将来情報および将来推定は、現時点当社が利用可能な情報および一定の前提または仮定(当社の主観的判断に基づくものを含みます。)に基づくものです。

実際の業績などは、国内外の経済情勢、半導体市況、為替動向、その他のリスク要因により、本資料に記載された将来情報および将来推定と大きく異なる可能性があります。



環境保護のために、
大豆インクを
使用しております。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。